

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

平4-98864

⑬ Int.CI.

H 01 L 23/50

識別記号

庁内整理番号

Y 9054-4M

⑭ 公開 平成4年(1992)3月31日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 樹脂封止型半導体装置

⑯ 登録番号 平2-216146

⑰ 出願日 平2(1990)8月16日

⑱ 発明者 高峰由佳子 熊本県熊本市八幡町100番地 九州日本電気株式会社内

⑲ 出願人 九州日本電気株式会社 熊本県熊本市八幡町100番地

⑳ 代理人 弁理士 内原晋

明細書

発明の名称

樹脂封止型半導体装置

特許請求の範囲

半導体チップを含んで封止した樹脂体と、前記半導体チップと電気的に接続して前記樹脂体の外部に導出した外部リードとを有する樹脂封止型半導体装置において、前記外部リードの周囲より開き合う外部リードへ向けて突出した支持部と、開き合う前記支持部の間に介在させて開き合う支持部を直に連結する絶縁体とを備えたことを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

発明の詳細な説明

(现有の利用分野)

本発明は樹脂封止型半導体装置に関する。

(従来の技術)

従来の樹脂封止型半導体装置は、第5図及び第

6図に示すように、アイランド1の周囲に配置して設けた内部リード2と、内部リード2に接続して樹脂封止領域3の外周に設けた外部リード4と、開き合う外部リード4の相互間を接続して支持するタイバー5とを有してリードフレームを構成し、アイランド1の上に半導体チップを搭載して樹脂体8で封止し、外部リード4をリードフレームから切離し、タイバー5を切離し、外部リード4を整形して半導体装置を形成する。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の樹脂封止型半導体装置は、外部リードが樹脂体より平行に矢印独立して導出されているので、外部リードが曲がる等の変形を生じ実装時に半田付の信頼性が低下するという欠点がある。

(課題を解決するための手段)

本発明の樹脂封止型半導体装置は、半導体チップを含んで封止した樹脂体と、前記半導体チップと電気的に接続して前記樹脂体の外部に導出した外部リードとを有する樹脂封止型半導体装置にお

いて、前記外部リードの周囲より開合う外部リードへ向けて突出した支持部と、開合う前記支持部の間に介在させて開合う支持部を互に連結する絕縁体とを備えている。

(実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明する。

第1図及び第2図は本発明の第1の実施例を説明するためのリードフレームの平面図及び半導体装置の側面図である。

第1図に示すように、アイランド1の周囲に配置して設けた内部リード2と、内部リード2と接続して樹脂封止領域3の外側に設けた外部リード4と、樹脂封止領域3の近傍に設けて外部リード4との相互間を接続して支持するタイバー5と、リード4の相手端を接続して支持するタイバー5と、樹脂封止領域3より離れた位置の外部リード4の周囲より開合う外部リードへ向けて突出し、且つ先端が互に入り組むように凸部と凹部に形成された支持部6と、開接する支持部6の間に介在させて支持部6を互に連結する絶縁体7とを有してリードフレームを構成する。

以上述べたように、本発明は、外部リード相互間を連結することにより、外部リードへ向けて突出した支持部6と、開接する支持部6の間に介在させて支持部6を互に連結する絶縁体7とを有してリードフレームを構成する。

図面の簡単な説明

第1図及び第2図は本発明の第1の実施例を説明するためのリードフレームの平面図及び半導体装置の側面図、第3図及び第4図は本発明の第2の実施例を説明するためのリードフレームの平面図及び半導体装置の側面図、第5図及び第6図は図及び半導体装置の側面図である。

1…アイランド、2…内部リード、3…樹脂封止領域、4…外部リード、5…タイバー、6…支持部、7…絶縁体、8…樹脂体。

代理人弁理士内原晋

ドフレームが構成される。

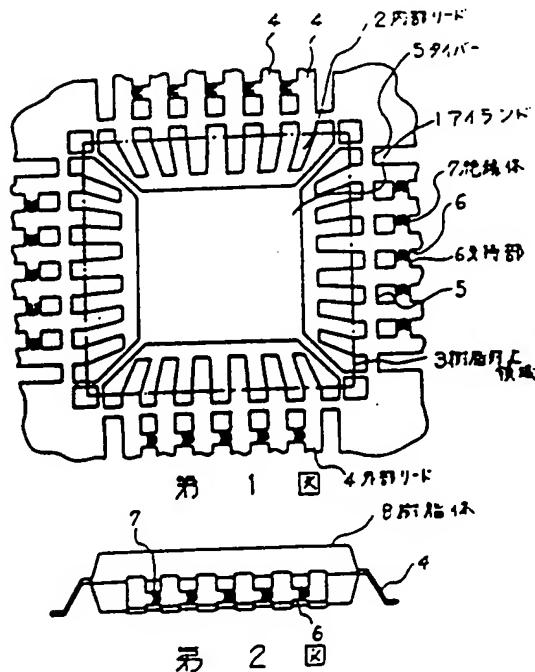
次に、第2図に示すようにアイランド上に半導体チップ(図示せず)を搭載し、半導体チップと内部リード間を電気的に接続し、樹脂体8により樹脂封止領域内を封止し、リードフレームより外部リード4及びタイバーを切離し、外部リード4を整形して半導体装置を構成する。

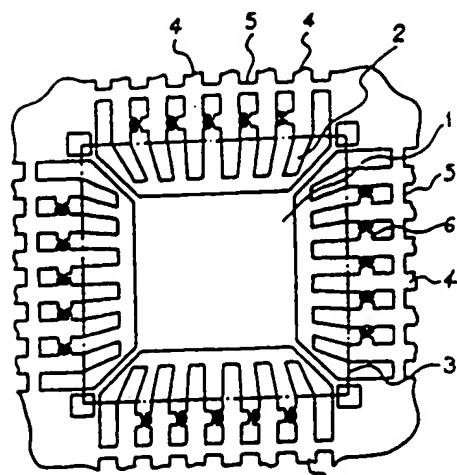
第3図及び第4図は本発明の第2の実施例を説明するためのリードフレームの平面図及び半導体装置の側面図である。

第3図及び第4図に示すように、開合う外部リード4の周囲に設けた支持部6が樹脂封止領域3の近傍に設けられ、タイバー5が支持部6の外側に設けられている以外は第1の実施例と同様の構成を有しており、支持部6を連結する絶縁体7を有しておらず、支持部6を連結する絶縁体7を樹脂封止工程と同時に形成でき、製造工程を簡略化できる効果を有する。

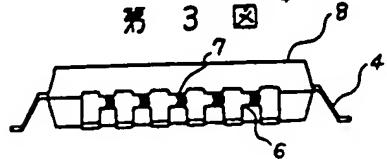
(発明の効果)

以上説明したように本発明は、外部リードの周囲に設けた支持部の間に絶縁体を介在させて開合

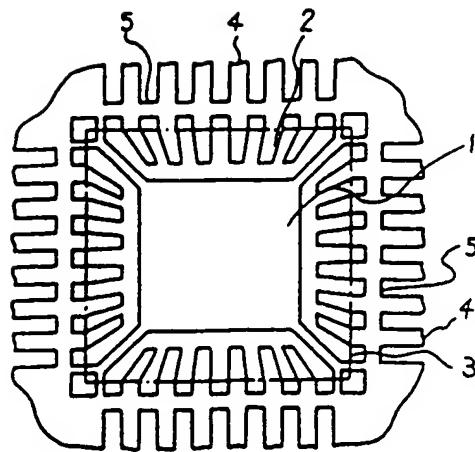




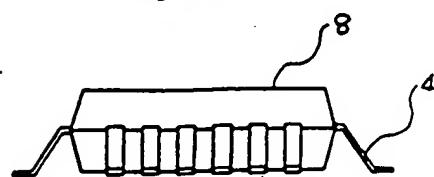
第 3 図



第 4 図



第 5 図



第 6 図

① 日本国特許庁 (JP) ② 特許出
③ 公開特許公報 (A) 平1-10

④ Int. Cl.
H 01 L 23/50
23/28

識別記号 廃内整理番号 ⑤公開 平成1年(19
G-7735-5F
A-6835-5F
審査請求 未請求 発明の数 1

⑥発明の名称 半導体集積回路装置

⑦特許 昭62-263435
⑧出願 昭62(1987)10月19日

⑨発明者 黒田 啓 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業
⑩発明者 高瀬 審久 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業
⑪出願人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
⑫代理人 弁理士 中尾・級男 外1名

明細書

1、発明の名称

半導体集積回路装置

2、特許請求の範囲

複数の電極端子を有するリードフレームの一主面の断面が、他の主面より狭く、このリードフレームの断面形状は少なくとも2段以上の段差を持つ段差部を有するものであり、半導体集積回路は他の主面にマウントされ、少なくとも電極端子の一主面を露出した形で一主面とは逆平面上に封止樹脂が形成されている半導体集積回路装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は半導体集積回路をパッケージした半導体集積回路装置に関するものである。

従来の技術

ポータブルな情報ファイルとしてのICカードはカードの一面上メモリ、マイクロプロセッサを有する半導体集積回路装置を埋込んで、リードワイヤーを介して情報を書き込み、読み出し、消去

する演算機能を持っているが、ICの規格カード厚みは最大0.84ミリとされており半導体集積回路装置は更に薄くしかも厚み強く要求される。

当初半導体集積回路装置の基板はガラスシートを基体とする両面基板が主流であったがエエボキシ基板ではICカード用半導体集積回路に要求する厚み精度を十分に満足させではなかった。

そこでガラスエエボキシ基板の代りに厚みよく半導体集積回路装置の底面の厚み精度をせられるリードフレームを基板とするIC用半導体集積回路装置が提案された。このカード用半導体集積回路装置の構造を以下に説明する。

複数本の電極端子1とダイパッド2をリードフレーム3の上記ダイパッド2間にIC4がマウントされ、上記IC4チップ3のパル (図示せず) と上記電極端子1がワイヤーバンドでシングルでなくとも上記電極端子1の-

らを露出した形で、しかも上記一主面⑥とほぼ平坦に封止樹脂⑦がトランシスファ成形法により成形された構造となっている。

ところが上記電極端子①の上記一主面⑥は外部に露出出し、上記電極端子①の薄い側面を含む片面しか上記封止樹脂⑦を接触していない。通常トランシスファ成形法で成形する上記封止樹脂⑦中には成形金型との離形性をよくするために、離形剤が入れられていることから、当然上記電極端子①と上記封止樹脂⑦との密着性は低いものではない。この問題点を解決する方法として、上記封止樹脂⑦と接触する他の主面⑧を粗面化したり、上記電極端子①の一主面⑥の面積を他の主面⑧の面積より狭くして(エッジにテープをつけ合形形状とする)密着性の向上を図っている。

発明が解決しようとする問題点

このような半導体集積回路装置に用いるリードフレーム⑨の厚味は、半導体集積回路装置に既厚の制限があることから0.15ミリ以下が通常用いられる。ところが封止樹脂⑦とリードフレーム⑨

なる。この状態でカード化しカードの機器中あるいは使用中に何らかの異物が切断面にできたバリ、あるいは電極端子自体にひっかかり電極端子をはがしてしまう可能性がある。このように電極端子がはがれたり、変形するとエコカードとしての機能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を鑑み、外的な力、熱ひずみ等に対しても電極端子がはがれて使用不能にならないようなりードフレームの構造を提供するものである。

問題点を解決するための手段

そして上記問題点を解決する本発明の技術的手段は、リードフレームの一主面の面積を他の主面より狭くし断面形状を凸型として一主面とほぼ平坦に封止樹脂を圧着し、リードフレームの端面を所定の距離、厚さでは金刃にわたって封止樹脂で覆うように構成したものである。

作用

この構成により電極端子①のばね刃が封止樹脂でしおわれていることから、電極端子を削る外因

の他の主面⑧との密着性を強化するため、リードフレーム⑨の断面をテーパ加工し、わずかに封止樹脂⑦でリードフレーム⑨を覆う形としているが、リードフレーム⑨の厚味が0.15ミリと非常に薄いため、封止樹脂⑦でリードフレーム⑨の端面を一部覆う形とした場合でもせいぜい厚味分の0.15ミリ程度しか覆うことができず、端面にテーパをつけた封止樹脂⑦に対するリードフレーム⑨の密着強度を著しく向上させることはできなかった。また前にも述べたが封止樹脂⑦との密着性が悪く、例えば熱衝撃試験を行った時に発生する熱的ひずみによりリードフレーム⑨が割れる可能性も生じてくる。更にトランシスファ成形法リードフレーム⑨の補強バーを封止樹脂⑦の端面に沿ってほぼ平坦に金型にて切断して細片の半導体集積回路装置にするわけであるが、補強バーの切断面は金型で切断する際、わずかなバリが発生することと、完全に封止樹脂⑦の端面と平坦にすることは不可能で、わずかに切断面が突き出る形と

からの力が加わらず、また熱衝撃試験等による熱的ひずみに対しても電極端子が割れることができないため信頼性の高い半導体集積回路装置を作ることが可能となる。

実施例

以下本発明の一実施例について図面を用いながら説明する。第2図⑩、⑪は本発明に用いたリードフレームの構造を示す。第2図⑩は上面図、第2図⑪はマークをみた断面図である。ダイバット⑪、複数本の電極端子⑫で構成されており、上記ダイバット⑪及び上記電極端子⑫の外周に露出する一主面⑯の面積は他の主面⑮より狭く、少なくとも封止樹脂で覆われる部分のリードフレーム⑨の断面は凸型の段差部⑯が設けられている。ちなみにリードフレーム⑨の肉厚が0.15ミリの場合上記段差部⑯の厚は0.5ミリ、りは0.1ミリとした。上記段差部⑯の断面形状は段差が1段のみならず複数段形成されてもかまわない。以上はダイバット⑪が複数本の電極端子⑫の少なくとも1本と複数それでハ

る構造のリードフレームである。このリードフレーム20の作製方法は一実施例として、まずプレス板でストレートにパンチングした後抜いて別の金型を用い同じくプレス板によりリードフレーム20の端面のみをプレスし所定の量だけ段差部16を作った。他の方針としてエッティングによる方法でも同様の段差部16を作ることは可能である。以上の説明はICチップを搭載するダイパッド11を有するリードフレーム20であるが、ダイパッド11のない電極端子12のみのリードフレームでもかまわない。

以上述べた款付きリードフレーム20を用いた半導体集積回路装置の製造プロセスを第3図a～cに示す。これは第2図のA-A'の断面を表わすものである。ダイパッド11の他の主面14にICチップ16をマウントし、上記ICチップ16のパッド(図示せず)と上記電極端子12との他の主面14をワイヤ17で接続し(第3図a)、次いでトランスクット成形法にて上記電極端子12、及びダイパッド11の一主面13を露出させるこ

のではなく、パンプを利用してリップチップポンディング方式でもかまわない。また同時にリードフレーム20の他の主面側をエッティング、サンドブラストメッキ法等で粗面化処理が施されていても良い。更にダイパッド11が無くICチップ16が電極端子12にかかるようリードフレーム20を用いる場合はICチップ16をマウントするダイガンド脚部は絶縁性であることはいうまでもない。

発明の効果

本発明の半導体集積回路装置はリードフレーム基板の端面に1段以上の段差部を設け、段差部を横う形で封止樹脂にて成形しているため、外的な力にも電極端子は剥れにくく、熱衝撃試験等の耐ひずみに対しても、電極端子ははがれないことから、信頼性の高いものを得ることが可望となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の半導体集積回路装置の一実施例における電極端子部の拡大俯視図、第2図a～cは本発明に用いたリードフレームの構造を示す

とく、上記一主面13とはほぼ平坦に封止樹脂18で成形する(第3図a)。この時リードフレーム20に設けられた段差部16も上記封止樹脂18で覆われる形となる。更に金型を用いて上記封止樹脂18の端面に沿って補強バー19を切断して個片の半導体集積回路装置とする(第3図c)。以上のべた半導体集積回路装置の電極端子部の大図を第1図に示す。この第1図によれば電極端子12の一主面と封止樹脂18とはほぼ平坦に成形されており、封止樹脂18に埋没した電極端子12の一端は、露出している一主面より広がっている構造となっている。このことは、電極端子12の端面に形成されている段差部16を完全に封止樹脂18が覆っていることになり、封止樹脂18の端面に露出している補強バー19も同様の凸型であることから外的な力に対しても非常に剥れに強い構造となっている。

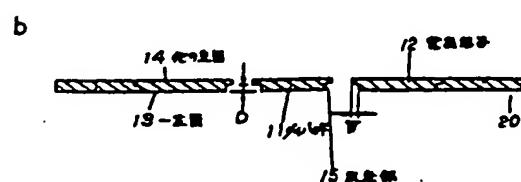
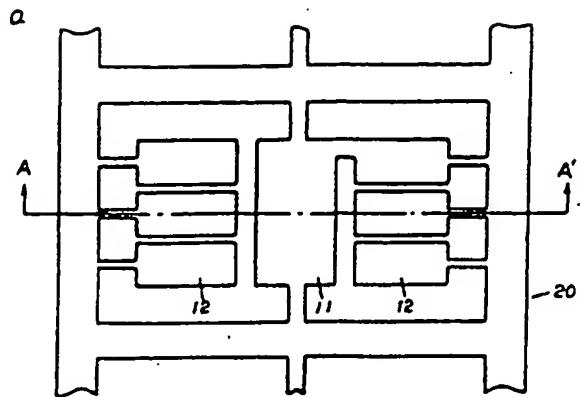
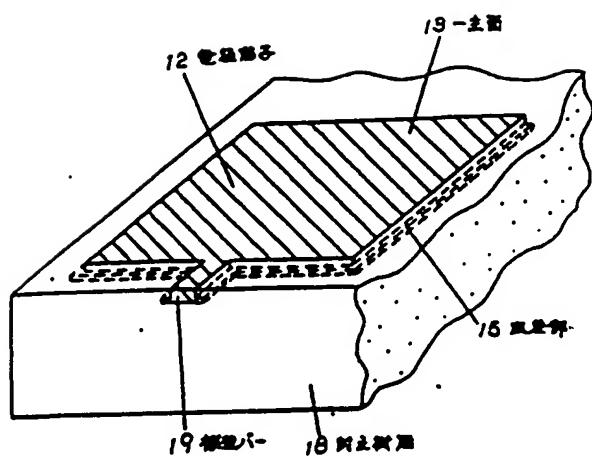
以上述べてきた実施例の中でICチップ16のパッドと電極端子12の接続にワイヤ17を用いているが、ワイヤーボンディング法に限定するも

上面図と断面図、第3図a～cは本発明の半導体集積回路装置の製造フローを示す断面図、第4図は従来のリードフレームを用いた半導体集積回路装置の構造を示す断面図である。

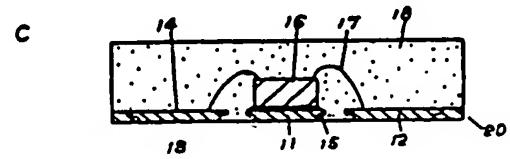
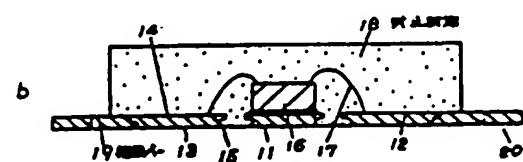
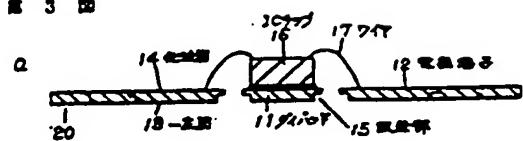
12……電極端子、13……一主面、14……他の主面、16……段差部、16……ICチップ、17……ワイヤ、18……封止樹脂、19……補強バー、20……リードフレーム。

代理人の氏名 兼歴士 中尾敏男 ほか1名

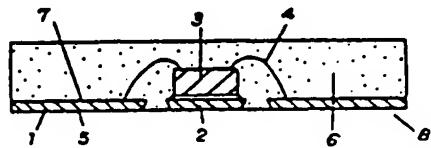
第1圖



第2圖



第3圖



CLIPPEDIMAGE= JP401106456A
PAT-NO: JP401106456A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A
TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME
KURODA, HIROSHI
TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD	N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to external force and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with a stair part having more than one step and performing molding with sealing resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11 may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to have very strong structure against coming-off even to external force.